



SCIENTECH

**辛耘企業(3583)**  
**2013年第三季法人說明會**

Nov 13, 2013

# 營運概況

## 簡明損益表



科目	2011	2012	2013/1Q	2013/2Q	2013/3Q	2013/1Q~3Q
營業收入	2,761,318	2,252,295	613,076	767,609	775,875	2,156,560
營業毛利	844,247	793,275	185,232	228,091	268,409	681,732
毛利率	30.57%	35.22%	30.21%	29.71%	34.59%	31.61%
營業費用	658,733	581,512	151,079	156,408	146,684	454,171
營業淨利(損)	185,514	211,763	34,153	71,683	121,725	227,561
營業利益率	7%	9%	6%	9%	16%	11%
稅前損益	163,762	210,838	42,049	70,136	100,749	212,934
稅前淨利率	6%	9%	7%	9%	13%	10%
稅後純益(損)	79,020	176,216	33,854	50,530	78,057	162,441
EPS(元)	1.21	2.38	0.45	0.62	0.96	2.05

# 營運概況

## 2013及2012 1-9M



科目	2012 1-9M	%	2013 1-9M	%	YoY
營業收入	1,642,550	100%	2,156,560	100%	<b>31%</b>
營業毛利	560,733	34%	681,732	32%	<b>22%</b>
營業費用	427,900	26%	454,171	21%	6%
營業淨利(損)	132,833	8%	227,561	11%	71%
稅前損益	124,414	8%	212,934	10%	<b>71%</b>
稅後純益(損)	100,610	6%	162,441	8%	<b>61%</b>
EPS(元)	<b>1.36</b>		<b>2.05</b>		

# 主要產品

## 自製設備



- 濕製程設備
  - 單晶圓/批次濕式製程設備
    - ◆ 8"/12"先進封裝製程:  
Bumping/TSV/3D
    - ◆ 6"/8"半導體前段成熟特殊製程 (RF、CMOS、Touch Controller、電源管理IC、MEMS)
    - ◆ III V族
    - ◆ LED全自動前段製程

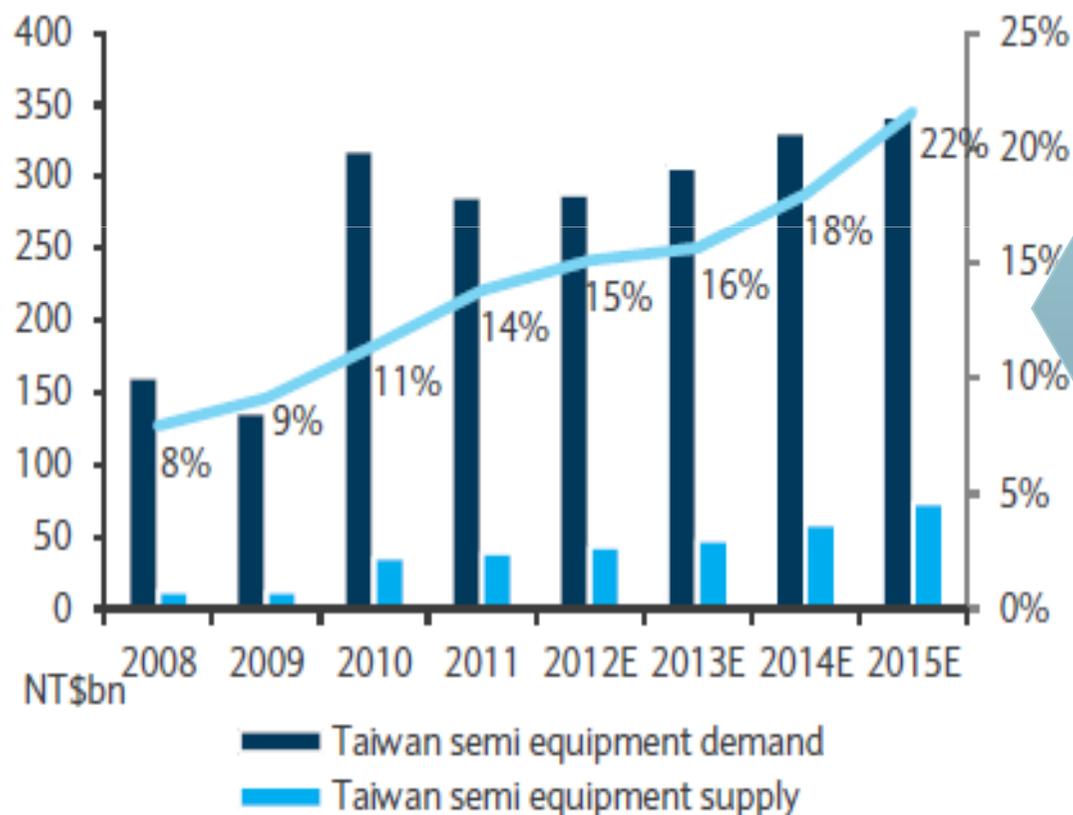


# 主要產品

# 自製設備



Taiwan semi equipment demand/supply



Source: Metal Industry Intelligence estimates, Barclays Research

- Taiwan semi equipment supply estimated
  - 2013: 16%
  - 2014: 18%
  - 2015: 22%
- High growth of local supply

# 主要產品

# 晶圓再生服務

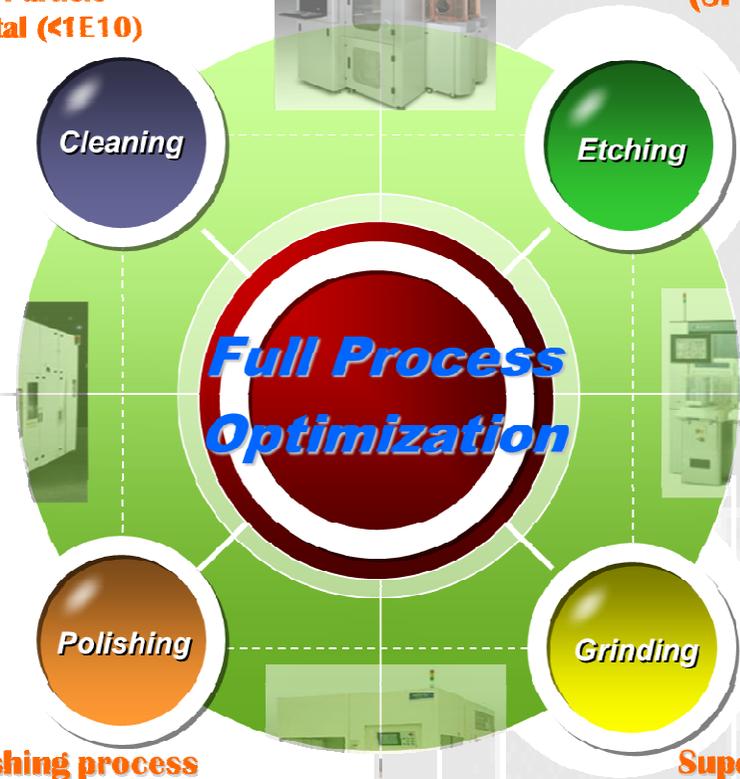


## Advanced clean technology

- 65nm/ 45nm Particle
- Low trace metal ( $<1E10$ )



## Complete particle inspection (SP1-DLS & SP2)



## Complete polishing process

## Super flatness (GBIR $<0.5\mu\text{m}$ )

- 12" Wafer Reclaim
- 月產能: 120K
- 銅製程與非銅製程產線分離。

# 主要產品

# 代理設備



Canon

FerroTec

Hirata

USHIO



NAKAN



FRT

Kensington LABORATORIES



Verity INSTRUMENTS, INC.



ECO-SNOW SYSTEMS



ADVANCED ENERGY

Plasma-Therm



RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL



タカノ株式会社

アユミ工業株式会社



# 未來展望

## 自製設備

- 國內半導體設備本土化趨勢明確，設備商具長期未來成長優勢。
- 高階凸塊封裝製程、矽穿孔、SiP、2.5D IC濕製程設備需求快速成長。
- 半導體前段成熟特殊製程、砷化鎵及LED先進製程全自動化需求確立。

## 晶圓再生

- 台灣12吋再生晶圓需求持續成長。
- 在週轉率及成本最佳化的需求條件下，本土化有其優勢。
- 晶圓再生技術及良率繼續提昇，降低成本，持續開發國外半導體廠訂單。

## 代理設備

- 2014年，28/20奈米產品線將成為台積電新的營收主力。
- 中國市場需求強勁。
- 優質新代理產品的持續加入，如 Plasma-Therm、AE 等等。

# 研發創新

## 自製設備

1. 製程世代能力提升
2. 以核心技術出發，持續掌握外部機會

單晶圓濕製程設備

雷射技術應用 導光板

全譜質譜儀

## 晶圓技術

1. 製程世代能力提升
2. 投入非矽材料技術

20/16 nm 晶圓再生技術  
18吋晶圓再生技術

非矽材料晶圓技術

SiC (矽):  
RF  
LED

Ge ( ):  
能

Glass ( ): 3D IC  
晶圓

簡報結束  
謝謝！

**Q&A**